

產學攜手計畫專案班(封裝測試產業精英專班)
110學年度進修部 電子工程系二技 課程規劃表

第一學年(110)					第二學年(111)							
	科目	上學期		下學期			科目	上學期		下學期		
		學分	時數	學分	時數			學分	時數	學分	時數	
校 必 修						校 必 修						
	小計						小計					
院 必 修						院 必 修						
	小計						小計					
通 識 教 育						通 識 教 育						
	小計						小計					
系 專 業 必 修	※封裝能力鑑定(一)	3	3			系 專 業 必 修	※測試能力鑑定(一)	3	3			
	※Tester設備操作與維修概論	3	3				※BIB治具設備操作與維修概論	3	3			
	※Handler設備操作與維修概論	3	3				※Laser Marker設備操作與維修概論	3	3			
	※HF設備操作與維修概論	3	3				※Lead Scanner原理與應用	3	3			
	※積體電路工程	3	3				※半導體製程實務	3	3			
	※半導體元件	3	3				※實務專題(一)	3	3			
	※半導體製程技術			3	3		※半導體產業分析			3	3	
	※積體電路可靠性工程			3	3		※實務專題(二)			3	3	
	※Oven設備操作與維修概論			3	3		※捲帶機原理與應用			3	3	
	※LD/UL設備操作與維修概論			3	3		※打線機原理與應用			3	3	
	※治具設備操作與維修概論			3	3		※黏晶機設備操作與維修概論			3	3	
	※封裝能力鑑定(二)			3	3		※測試能力鑑定(二)			3	3	
	小計	18	18	18	18		小計	18	18	18	18	
系 專 業 選 修						系 專 業 選 修						

注意事項：

- 1.畢業應修學分為72學分；含必修： 72 學分，選修：0 學分。
- 2.表列選修課程僅供參考，依實際狀況調整。